

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

二零二五年第三季度業績新聞稿

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止三個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



ASMPPT 公布二零二五年第三季度業績

人工智能推動強勁勢頭

集團業績概覽

關鍵亮點

- * 先進封裝及主流業務均受惠於人工智能
- * TCB 技術於第四代高頻寬記憶體及先進邏輯領域保持領導地位
- * 來自記憶體及邏輯客戶的重複 TCB 訂單
- * SMT 復蘇，新增訂單總額勝預期
- * 經調整，本季度盈利（不包括策略性重組成本）

集團財務概要: 二零二五年第三季度

(港幣百萬元)	二零二五年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	3,620.7 (4.63 億美元)	-3.5%	+14.2%
銷售收入	3,661.2 (4.68 億美元)	+7.6%	+9.5%
毛利率	35.7%	-405 點子	-532 點子
經營利潤	50.5	-70.2%	-71.7%
盈利/(虧損)	(268.6)	NM	NM
每股基本盈利	港幣(0.65)元	NM	NM
非香港財務報告會計準則計量¹			
經調整毛利率	37.7%	-203 點子	-330 點子
經調整經營利潤	124.4	-26.6%	-30.3%
經調整盈利	101.9	-24.4%	+245.2%
經調整每股基本盈利	港幣 0.24 元	-25.0%	+200.0%

NM: 無意義

二零二五年第四季度銷售收入預測

- * 將介乎 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季+6.8%，按年亦+14.3%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmppt.com/en/investor-relations/financial-information/>

¹ 有關上述非香港財務報告會計準則計量之詳情，請參閱集團二零二五年第三季度業績公告「香港財務報告會計準則計量對非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節。

(二零二五年十月二十八日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」 / 「集團」 / 「公司」) (股份代號: 0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬體和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二五年九月三十日止三個月之第三季度業績。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「人工智能的增長持續惠及我們的先進封裝和主流業務。在TCB領域，集團於第四代高頻寬記憶體與先進邏輯領域均持續獲得重複訂單，鞏固了我們的技術領導地位。近期有關人工智能生態系統投資的消息，使我們更有信心TCB的總潛在市場規模將在二零二七年突破10億美元。再加上表面貼裝技術解決方案分部業務新增訂單總額勝過預期，集團整體業務持續朝正面方向發展。」

集團二零二五年第三季度摘要

集團的先進封裝 (「AP」) 及主流業務繼續受惠於人工智能的持續採用。在先進封裝業務方面，其熱壓焊接 (「TCB」) 解決方案在先進記憶體及邏輯應用領域均成功獲得客戶重複訂單。包括數據中心、數據傳輸及能源管理的人工智能基礎設施，推動了對主流業務的需求。在中國市場，電動汽車 (「EV」) 及外判半導體裝嵌及測試企業的高廠房利用率亦帶動需求。然而，中國以外的汽車及工業市場的貢獻仍然疲弱。

- 銷售收入為港幣36.6億元 (4.68億美元)，按季增長7.6%，按年亦增長9.5%，主要受表面貼裝技術解決方案分部的增長所推動。
- 受人工智能所推動，於二零二五年第三季度集團的新增訂單總額為 4.63 億美元，連續第六個季度實現按年增長。若不包括因一間領先高密度基板製造商由於消化現有產能的速度慢於其預期，而於二零二五年第三季度取消了其面板沉積設備個別訂單之影響，該季度的新增訂單總額將為 4.87 億美元，按季增長 1.5%，按年亦增長 20.1%。
- 於季內錄得訂單對付運比率為1.04，自二零二五年第一季度以來維持在1以上的比率。表面貼裝技術解決方案分部的比率高達1.12，而半導體解決方案分部的比率則為0.96。
- 經調整毛利率為37.7%，按季下降203點子，按年亦下降330點子，主要由於表面貼裝技術解決方案分部重大貢獻，及半導體解決方案分部的產品組合和相對較低的製造利用率。
- 營運支出 (「OPEX」) 為港幣12.6億元，按季增長6.2%，按年亦增長5.3%。亦如預期，營運支出增加主要是由於策略性研發、資訊技術基礎設施投資及外幣匯兌所致，部分被審慎的支出管控及重組效益所抵銷。
- 經調整經營利潤為港幣1.24億元，按季下降26.6%，按年亦下降30.3%，主要受毛利率下降和營運開支上升所致。

- 經調整盈利為港幣1.02億元，按季下降24.4%，按年則增長245.2%。按季包括了上述取消訂單而收取的費用，及無上季度稅項抵免入賬所抵銷。
- 淨虧損港幣 2.69 億元主要由於子公司（先進半導體設備（深圳）有限公司（「AEC」））的自願性清盤而產生的重組成本及存貨註銷，相關支出涉及港幣 3.71 億元所致。

先進封裝 – 人工智能推動需求

集團在先進封裝市場的強勢地位，主要由於其 TCB 在先進邏輯領域持續佔據領導地位，過去一年迅速進軍高頻寬記憶體（「HBM」）市場，以及在第四代高頻寬記憶體方面具有先發優勢。

在 TCB 方面，集團針對 12 層第四代高頻寬記憶體所推出的解決方案率先接獲多家高頻寬記憶體企業的訂單，並預計將繼續成為一間主要供應商，展現其在迅速轉型至第四代高頻寬記憶體方面的技術領導地位。集團的免助焊劑主動去除氧化（「AOR」）專有技術，具備卓越的可擴展性，可為 16 層及以上高頻寬記憶體應用，同時實現最低轉型成本。在邏輯方面，集團繼續贏得主要客戶在晶片到基底（「C2S」）應用工藝標準（「POR」）訂單。隨著市場轉向採用更大的複合固晶，集團已準備就緒，將於二零二五年第四季度及之後從領先晶圓代工的外判半導體裝嵌及測試合作夥伴獲得大額訂單。集團的晶片到晶圓（「C2W」）超微間距 TCB 等離子主動去除氧化解決方案已通過領先晶圓代工客戶的最終質量及可靠性認證，並已準備大批量生產。相關等離子技術已得到上述領先晶圓代工客戶的認可，突顯了其較其他工藝的技術優勢。

在混合式焊接（「HB」）方面，集團繼續交付混合式焊接工具，其中第二代混合式焊接解決方案在精確對正、焊接準確度、生產布局效率、每小時產能（「UPH」）方面具競爭優勢。集團亦積極與主要邏輯及記憶體企業合作，各個項目正處於不同的評估階段。

在光子和共同封裝光學（「CPO」）方面，集團繼續主導光學收發器市場，鞏固其作為 800G 收發器主要供應商的領導地位，同時積極與行內企業合作開發新一代 1.6T 光子解決方案。集團的共同封裝光學解決方案具使其傲視同儕的技術優勢，並已與主要共同封裝光學企業緊密合作。

在表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝解決方案方面，表面貼裝技術解決方案分部獲得來自整合設備製造商客戶及外判半導體裝嵌及測試企業的大量系統封裝訂單（「SiP」），提供基站射頻模組以支持人工智能的發展。此外，表面貼裝技術解決方案分部亦繼續取得來自一間領先晶圓代工和多間外判半導體裝嵌及測試企業用於先進邏輯智能手機應用的新一代晶片裝嵌工具更多訂單。

主流業務 – 人工智能及中國市場推動需求

人工智能的需求繼續惠及集團的主流業務，主要受數據中心對增強能源管理能力及基站對人工智能伺服器主機板的需求提升所驅動。在中國市場，主流業務在半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部方面的需求持續增長。半導體解決方案分部的焊線機及固晶機應用的新增訂單總額，受惠於外判半導體裝嵌及測試廠房利用率持續提高所驅動，而表面貼裝技術解決方案分部的需求主要來自電動汽車，其在中國仍保持領先地位。

前景

集團預期二零二五年第四季度的銷售收入將介乎於 4.7 億美元至 5.3 億美元之間，以其中位數計按季增長 6.8%，按年亦增長 14.3%，高於市場預期。此增長將同時由半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的勢頭所驅動。

展望未來，受益於近期有關人工智能生態系統投資的消息，集團預計其 TCB 總潛在市場將於二零二七年突破 10 億美元。人工智能數據中心將持續推動對先進封裝的需求，尤其是用於第四代高頻寬記憶體及先進邏輯的 TCB，集團正是該領域的技術領導者。

集團的主流業務將受惠於全球對人工智能基礎設施的投資，以及來自中國的穩定需求。然而，汽車及工業終端市場的復蘇前景仍不明朗。

儘管集團尚未受到關稅政策的任何重大影響，但認同存在不確定性。憑藉其全球佈局，集團能夠靈活應對任何潛在影響，其將繼續密切關注局勢，並根據需要進行調整。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT也是[半導體氣候聯盟](#)的創始成員之一。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁www.asmp.com。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而 ASMPT 不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
電話：+65 6450 1445
電郵：eg.lim@asmp.com

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣 / 沈吉
電話：+852 2864 4812 / 2864 4862 / 2864 4870
傳真：+852 2527 1196
電郵：mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk / angela.shen@sprg.com.hk